

「ナノマテリアルジョイントミーティング 2023」

主催 京都先端技術研究会、(地独)京都市産業技術研究所、共催 京都ものづくり協力会

一般的に材料は、ナノ化し比表面積が非常に大きくなることで、さまざまな興味深い物性を示すようになります。近年、電子材料、バイオ、触媒など、多くの分野でこのようなナノ材料の活用が期待され、注目を浴びています。しかし、その合成や評価に関してはテクニック、ノウハウに頼っている部分はまだあり、結果として用途や市場の広がりも限定的になっているという側面もあります。そこで、京都先端技術研究会、(地独)京都市産業技術研究所では、ナノ材料を扱っておられる企業様、あるいはこれからナノ材料を扱うことを検討されておりご興味のある企業様との情報交換を目的として、ナノ材料開発に関する技術会議を開催いたします。今回は、“電子材料への応用”に焦点を当て、**ナノ粒子の焼結を利用した回路形成や接合等への応用事例**について、また、招待講演では大阪公立大学 原田先生をお招きし、**ナノ粒子の分散安定性制御と回収技術**についてのご講演を賜ります。

本技術会議を通じてナノ材料の可能性について情報共有を図り、今後のナノ材料のさらなる展開や市場拡大につながることを期待しております。皆さまのご参加をお待ちしております。

記

日時 令和5年11月1日(水) 13:30~17:00

会場 京都市産業技術研究所 2階 ホール

内容 研究紹介：

「Cu ナノ粒子の粒径分布制御と焼結接合技術への応用」

(地独)京都市産業技術研究所 加工・製造技術グループ 塩見昌平

講演①：

「Cu ナノ粒子・Cu₂O ナノインクの開発と電子材料への応用」

福田金属箔粉工業株式会社 技術本部 研究開発部 上林景太 氏

講演②：

「導電性 Cu ナノインク・ペーストの焼成と回路形成・パワーデバイス向け接合材料への応用」

石原ケミカル株式会社 第三研究部 有村英俊 氏

招待講演：

「機能性高分子を利用した金属ナノ粒子の分散安定性制御と回収技術」

大阪公立大学大学院工学研究科 物質化学生命系専攻 原田敦史 氏

名刺交換会

対象 ナノ材料に興味・関心をお持ちの方

定員 30名（先着順）

参加費 2,000円（ただし、京都先端技術研究会、京都ものづくり協力会会員は無料）
※当日、会場受付にてお支払いください

申込み 下記注意事項をよくお読みいただき、申込フォームから申込みください。
申込フォーム：<https://questant.jp/q/0YE1IAYD>
※お申込み後72時間以内に申込確認メールがない場合はご連絡ください。

注意事項

- お申込みは1名ごととなります。複数名でのご参加をご希望の際も1名ごとにお申込みください。
- 感染症拡大等の状況によっては中止またはオンライン開催に変更となる可能性があります。その際は参加申込時にご記載いただいたメールアドレス宛に連絡いたしますので、ご確認をお願いいたします。
- 発熱等の症状がある方は来場をご遠慮ください。
- 感染予防のため、スタッフ等はマスクを着用している場合があることをご了承ください。

問合せ 〒600-8815 京都市下京区中堂寺栗田町91 京都リサーチパーク9号館南棟
TEL：075-326-6100(代表)
Eメール：kyoto-sentan_1985(at)tc-kyoto.or.jp ※(at)部分を@に変えてご利用ください。
加工・製造技術グループ 塩見

